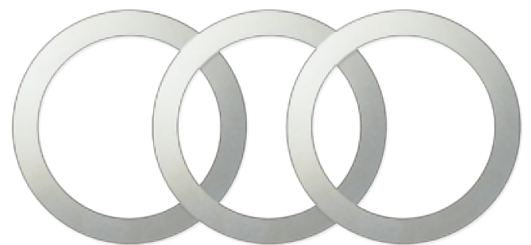


PRECISION ACCRETECH BLADE
NICKEL BOND BLADES
ニッケルブレードGSタイプ

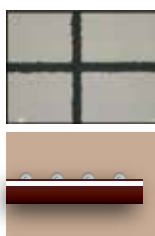


ニッケルブレードの世界を変える、
切れ味と剛性を兼ね備えた最新シリーズ。
チッピング、クラックの制御を目指し進化を続ける、
次世代ブレード登場。

- 2011年リリース
- 高脆性材料、薄刃用途向けに開発
- 切れ味を極限まで向上
- ニッケルブレードでレジンブレードの世界の実現に成功
- 砥粒径ラインナップの拡充とアプリケーションの拡大を予定



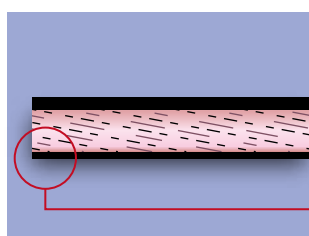
■加工例 ニッケルブレード(GSタイプ)



シリコン表面

断面

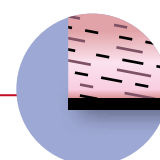
■ BSI CMOSセンサー切断
フルカットにてシリコン表面チッピング、接合面クラック、裏面ガラスチッピングを制御したブレードを開発。今後のニーズに対応できるよう開発し続けています。

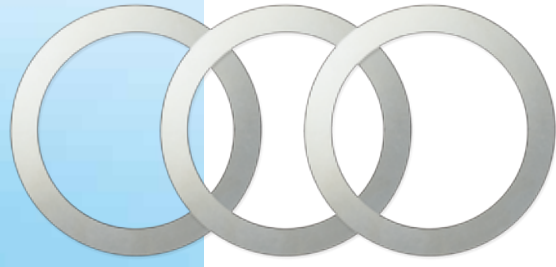


LT基板断面

■ 脆性材料切断

切れ味と剛性を兼ね備えているため、薄いブレードにて品位よく切断が可能となりました。





仕様と表示方法

1A8	S		
形状	スリット		
D	6/12	-	GS
砥粒	砥粒径		タイプ

スリット

S	標準タイプ
SN	斜めタイプ

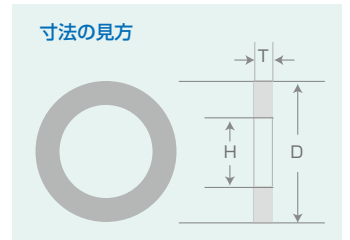
寸法と表示方法

52D	0.05T	40H	2D	1W	16N
外径	刃厚	内径	スリット深さ	スリット幅	スリット本数

寸法規格

外径(mm)		刃厚(mm)		内径(mm)	
製造可能寸法	公差	製造可能寸法	公差	製造可能寸法	公差
50~80	+0.02 -0	0.04<0.06 0.06≦0.2	±0.003 ±0.005	25.4~88.9	H6

寸法の見方



製造対応砥粒径

砥粒径 um	粒度
6/12	1200
5/10	1300
4/8	2000

■ご注文に際して

ご注文にあたっては、当社カタログを参考に下記の項目について出来るだけ詳しくお知らせ下さい。

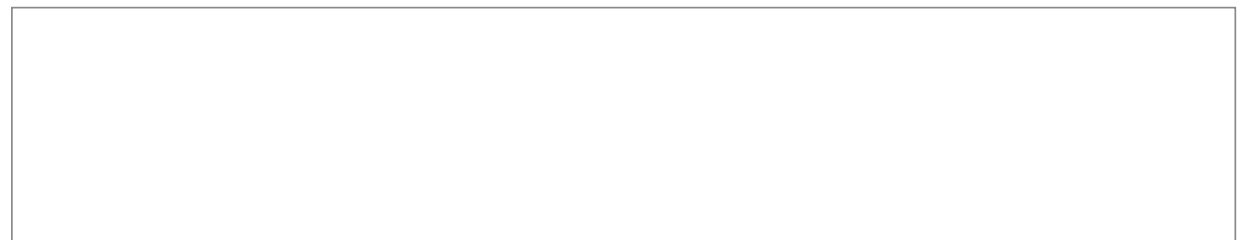
- 1) 形状、寸法／具体的ブレード形状とご要求精度等
- 2) 仕様／ご希望の弊社仕様、現在ご使用中の製品の使用等
- 3) 切断ワーク・切断条件／使用機器、回転数、送り速度、クーラント流量等

■ご使用に際して

安全に使用していただくために、またブレードの性能を十分に引き出すために、ご使用前に製品に添付されている取り扱い説明書及び検査票の記載事項、加工機取り扱い説明書を良くお読みの上ご使用下さい。

※本カタログは予告なく変更することがあります。

※本カタログは製品性能を保証するものではありません。



株式会社東京精密